## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## DEUTSCHES PATENTAMT

AUSGEGEBEN AM 18. APRIL 1957

> BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTÉS

# PATENTSCHRIFT

M: 962 251

KLASSE 12i GRUPPE 16

INTERNAT. KLASSE C01b

D 18028 IVa / 12i

Heinrich Meier-Ewert, Rheinfelden (Bad.)
ist als Erfinder genannt worden

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt/M.

Anlagerungsverbindungen von Wasserstoffperoxyd an Siliciumdioxyd und Verfahren zu ihrer Herstellung

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 19. Juni 1954 an Patentanmeldung bekanntgemacht am 25. Oktober 1956 Patenterteilung bekanntgemacht am 4. April 1957

Es sind schon Anlagerungsverbindungen von Wasserstoffperoxyd und Wasser an Kieselsäure bekannt, die die Zusammensetzung SiO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>·2 H<sub>2</sub>O, SiO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O, SiO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder 2 SiO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> haben. Diese Anlagerungsverbindungen enthalten die Bestandteile in stöchiometrischen Mengen. Erhalten werden sie durch Versetzen einer wäßrigen Lösung oder Suspension von gelförmigem Siliciumdioxyd mit einer wäßrigen Lösung von Wasserstoffperoxyd. Eine technische oder praktische Bedeutung haben sie bisher nicht erhalten (vgl. Krauß und Oettner, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, Bd. 222, 1935, S. 345).

Es wurde nun gefunden, daß es neben diesen Verbindungen auch noch Anlagerungsprodukte von Wasserstoffperoxyd und Wasser an feinverteiltes Siliciumdioxyd gibt, deren Bestandteile nicht im stöchiometrischen Verhältnis zusammentreten. Es handelt sich hierbei anscheinend nicht um chemische Verbindungen, sondern offenbar um mehr oder weniger lockere Anlagerungsprodukte, deren Zusammensetzung innerhalb weiter Grenzen schwanken kann.

Es hat sich gezeigt, daß derartige Anlagerungsprodukte, die aus feinverteiltem Siliciumdioxyd, Wasserstoffperoxyd und Wasser besteben, im allgemeinen nicht sehr beständig sind, so daß eine längere Lagerung nicht möglich ist. Schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit verlieren diese Anlagerungsprodukte einen wesentlichen Teil des in ihnen enthaltenen Wasserstoffperoxyds.

Es wurde weiterhin gefunden, daß die Stabilität in sehr erheblichem Maße von der Reinheit des als Träger verwendeten feinteiligen Siliciumdioxyds abhängt. Stellt man nach einer bevorzugten Aus-5 führungsform der Erfindung solche Anlagerungsprodukte zusammen, die Siliciumdioxyd von hoher Reinheit enthalten, so wird die Beständigkeit der erhaltenen Produkte wesentlich gesteigert. Insbesondere hat es sich gezeigt, daß Verunreini-10 gungen von Aluminiumoxyd, Titandioxyd oder Eisenoxyd die Stabilität sehr ungünstig beeinflussen. Daher ist es in jedem Fall vorteilhaft, für solche Anlagerungsprodukte ein Siliciumdioxyd zu verwenden, das weniger als 0,005 Gewichtsprozent der genannten Verunreinigungen enthält.

Besonders vorteilhaft für die Herstellung der erfindungsmäßigen Anlagerungsprodukte ist ein feinteiliges Siliciumdioxyd, das auf thermischem Wege durch Oxydation oder Hydrolyse flüchtiger Sili-20. ciumverbindungen in der Gasphase hergestellt ist. Ein solches Siliciumdioxyd zeichnet sich durch sehr hohe Teilchenfeinheit, eine aktive Oberflächenstruktur und sehr gleichmäßige Korngröße

Um die Lagerbeständigkeit der Produkte weiter zu erhöhen, empfiehlt es sich, ihnen geringe Mengen an sich bekannter Stabilisatoren zuzusetzen. Beispielsweise seien hierbei Weinsäure, Dipicolinsäure, 8-Oxychinolin oder p-Oxybenzoesäure-30 methylester genannt.

Überraschenderweise wurde festgestellt, daß Anlagerungsprodukte, die verhältnismäßig viel Wasserstoffperoxyd enthalten, im allgemeinen lagerbeständiger sind als solche mit einem geringen Gehalt 35 von Wasserstoffperoxyd. Daher empfiehlt es sich, Produkte zu verwenden, die über 20%, vorzugsweise über 25%, Wasserstoffperoxyd enthalten.

Die erfindungsmäßigen Anlagerungsprodukte können in einfacher Weise hergestellt werden. Man kann z. B. feinverteiltes Siliciumdioxyd mit einer wäßrigen, vorzugsweise konzentrierten Lösung von Wasserstoffperoxyd innig vermengen. Das erhaltene Gemisch ist ein leichtes, weißes Pulver.

Um eine gleichmäßige Aufnahme des Wasser-45 stoffperoxyds durch das Silicium dioxyd zu erreichen, empfiehlt es sich auch, das Siliciumdioxyd in aufgewirbeltem Zustand mit einer versprühten wäßrigen Lösung von Wasserstoffperoxyd zu versetzen.

Die etwa zu verwendenden Stabilisatoren werden bei diesem Verfahren zweckmäßig schon der Lösung des Wasserstoffperoxyds zugesetzt.

Will man ein Anlagerungsprodukt mit einem höheren Gehalt von Wasserstoffperoxyd erhalten, 55 so empfiehlt es sich, das durch Versetzen des Siliciumdioxyds mit der Wasserstoffperoxydlösung erhaltene Produkt vorsichtig bei gelinder Temperatur, zweckmäßig im Vakuum, zu trocknen.

Anlagerungsprodukte erfindungsmäßigen 60 können in verschiedenster Weise technisch verwendet werden. Man kann sie z. B. als Katalysatoren für Polymerisationen gebrauchen, wobei das entstehende Polymerisat gleichzeitig einen gewissen

Gehalt von Siliciumdioxyd enthält, der für manche Zwecke gewünscht ist. Auch für medizinische Zwecke lassen sich die Produkte verwenden.

#### Beispiel 1

100 Gewichtsteile feinverteiltes Siliciumdioxyd, das auf thermischem Wege durch Hydrolyse von Siliciumtetrachlorid erhalten ist und das 0,0011% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 0,0032% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und weniger als 0,001% Ti O<sub>2</sub> enthält, wird unter Rühren mit 100 Gewichtsteilen einer 40% igen H.O.-Lösung versetzt, die 0,2% 8-Oxychmolin enthält. Das entstandene Anlagerungsprodukt hat einen H2O2-Gehalt von 24,7 %. Bei der Lagerung bei Zimmertemperatur immerhalb eines Monats nimmt der Gehalt an Wasserstoffperoxyd nur um 0,2% ab.

#### Beispiel 2

100 Gewichtsteile feinverteiltes Siliciumdioxyd derselben Zusammensetzung wie im Beispiel 1 werden unter Aufwirbeln mit 100 Gewichtsteilen einer 40% igen Lösung von Wasserstoffperoxyd, die 2% p-Oxybenzoesäuremethylester enthält, in versprühtem Zustand vermengt. Das Gemenge wird vorsichtig bei 40° im Vakuum getrocknet. Das Endprodukt enthält 29,4% H2O2 und gibt beim Lagern bei Zimmertemperatur innerhalb eines Monats nur 0,1% des Wasserstoffperoxyds ab.

### PATENTANSPRÜCHE:

 Anlagerungsprodukt von Wasserstoffperoxyd an Kieselsäure, bestehend aus feinverteiltem Siliciumdioxyd, vorzugsweise von hoher Reinheit, Wasserstoffperoxyd und Wasser.

100

2. Anlagerungsprodukt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Siliciumdioxyd nicht mehr als 0,005% Aluminiumoxyd, Titandioxyd oder Eisenoxyd enthält.

3. Anlagerungsprodukt nach Anspruch i 105 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es feinteiliges Siliciumdioxyd enthält, das auf thermischem Wege durch Oxydation oder Hydrolyse flüchtiger Siliciumverbindungen in der Gasphase hergestellt ist.

4. Anlagerungsprodukt nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß es geringe

Mengen stabilisierender Stoffe enthält.

5. Anlagerungsprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es 115 über 20%, vorzugsweise über 25%, Wasserstoffperoxyd enthält.

6. Verfahren zur Herstellung eines Anlagerungsproduktes nach einem der Ansprüche i bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß feinverteiltes Siliciumdioxyd mit einer wäßrigen, vorzugsweise konzentrierten Lösung von Wasser-

stoffperoxyd innig vermengt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß feinverteiltes Siliciumdioxyd 12 in aufgewirbeltem Zustand mit einer versprühten wäßrigen Lösung von Wasserstoff-

peroxyd versetzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der wäßrigen Lösung des Wasserstoffperoxyds ein Stabilisator zugesetzt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6,7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß das erhaltene Gemenge von Siliciumdioxyd, Wasserstoffperoxyd und Wasser vorsichtig bei gelinder Temperatur, vorteilhaft im Vakuum, entwässert wird.